



中国电子学会电子制造与封装技术分会会刊
中国半导体行业协会封装分会会刊



Q K 2 2 5 1 8 7 2

电子与封装

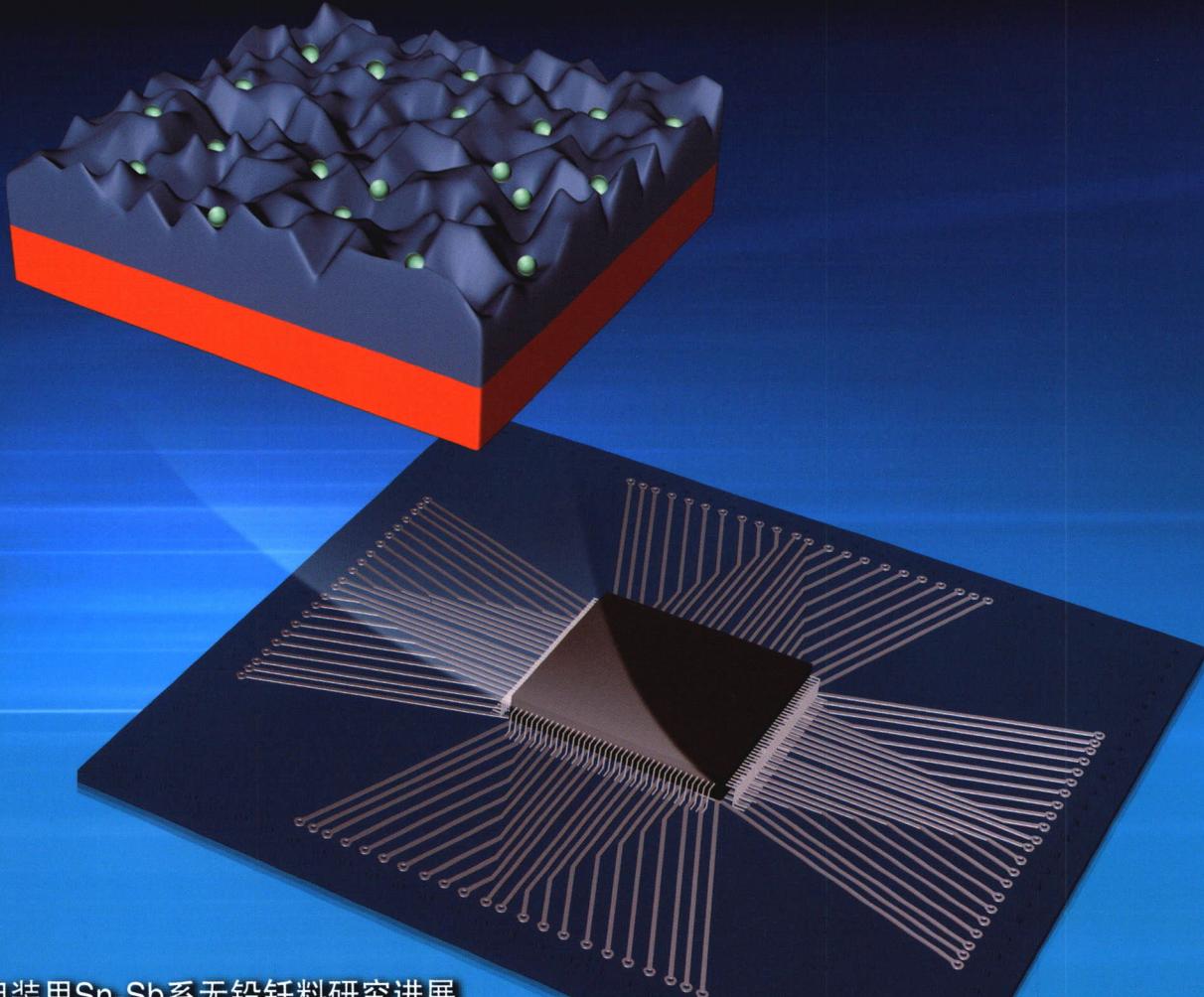


ELECTRONICS & PACKAGING

第23卷 第2期
2023.02



扫码关注期刊
微信公众号



电子组装用Sn-Sb系无铅钎料研究进展

P020201

ISSN 1681-1070



9 771681 107234

www.ep.org.cn

主管：中国电子科技集团有限公司

主办：中国电子科技集团公司第五十八研究所

万方数据

电子与封装

第 23 卷 第 2 期 2023 年 2 月

(总第 238 期)

目 次

·封装、组装与测试·

电子组装用 Sn-Sb 系无铅钎料研究进展(封面文章 / 特邀综述)	王曦, 张亮, 李木兰, 姜楠	020201
导电胶粘接片式器件的接触电阻试验研究	李文, 冯雪华, 张信波, 朱小会	020202
铜带缠绕型 CCGA 的加固工艺参数优化	张国光, 田文超, 刘美君, 从昀昊, 陈思, 王永坤	020203
塑封倒装焊焊点开裂分析及改善研究	朱国灵, 季振凯, 纪萍, 徐小明	020204
高带宽存储器的技术演进和测试挑战(综述)	陈煜海, 余永涛, 刘天照, 刘焱, 罗军, 王小强	020205
高密度陶瓷外壳焊盘位置度的标注与测量方法	刘洋, 杨振涛, 刘林杰	020206

·电路与系统·

基于 RISC-V 芯片的内置 Flash 自编程实现方式	张文文, 来鹏飞	020301
一种输出可调的高精度开关电容基准电压源	许超, 吴叶, 常伟, 李珂	020302
用于宽带任意波发生器的可变增益放大器	罗阳, 乘舰, 周磊, 武锦	020303
基于 Python 的级联半带滤波器 RTL 自动生成方法	何秋秀, 李晓蓉, 邵杰, 卓琳	020304
基于组合混沌的多精度流加密方案	周宇, 李巧, 刘静, 王骏超	020305
基于 RISC-V 的神经网络加速器硬件实现	鞠虎, 高营, 田青, 周颖	020306

·材料、器件与工艺·

基于过程控制和参数分布能力的元器件质量评价方法	李剑东, 孙明, 张海明, 宁永成, 蒋承志	020401
多重场限环型终端结构的优化设计	卓宁泽, 赖信彭, 于世珩	020402

·封装前沿报道·

兼具高绝缘和耐热性能的环氧封装材料的设计及制备	张松, 杜斌	020601
-------------------------------	--------	--------

Electronics & Packaging

Vol.23, No.2 (Series No.238) Feb 2023

CONTENTS

·Packaging & Assembly & Testing·

- Research Progress of Sn-Sb Lead-Free Solders in Electronic Assemble(Cover Paper/Invited Paper)
..... *WANG Xi, ZHANG Liang, LI Mulan, JIANG Nan* 020201
- Experimental Study on Contact Resistance of Conductive Adhesive Bonded Chip Device
..... *LI Wen, FENG Xuehua, ZHANG Xinbo, ZHU Xiaohui* 020202
- Optimization of Reinforcement Process Parameters for Copper Tape Winding CCGA
..... *ZHANG Guoguang, TIAN Wenchao, LIU Meijun, CONG Yunhao, CHEN Si, WANG Yongkun* 020203
- Analysis and Improvement of Flip-Chip for Bump Crack in Plastic Packaging
..... *ZHU Guoling, JI Zhenkai, JI Ping, XU Xiaoming* 020204
- Technology Evolution and Testing Challenges of High Bandwidth Memory(Review)
..... *CHEN Yuhai, YU Yongtao, LIU Tianzhao, LIU Yan, LUO Jun, WANG Xiaoqiang* 020205
- Marking and Measuring Method of Pad Position for High Density Ceramic Shell
..... *LIU Yang, YANG Zhentao, LIU Linjie* 020206

·Circuit & System·

- Self-Programming Implementation of Built-in Flash Based on RISC-V Chip
..... *ZHANG Wenwen, LAI Pengfei* 020301
- High Precision Switch Capacitor Reference Voltage Source with Adjustable Output
..... *XU Chao, WU Ye, CHANG Wei, LI Ke* 020302
- Variable Gain Amplifier for Broadband Arbitrary Waveform Generator
..... *LUO Yang, LUAN Jian, ZHOU Lei, WU Jin* 020303
- Method of Automatically Generating Cascaded Half-Band Filter RTL Based on Python
..... *HE Qiuxiu, LI Xiaorong, SHAO Jie, ZHUO Lin* 020304
- Multi-Precision Stream Encryption Scheme Based on Combinatorial Chaos
..... *ZHOU Yu, LI Qiao, LIU Jing, WANG Junchao* 020305
- Hardware Implementation of Neural Network Accelerator Based on RISC-V
..... *JU Hu, GAO Ying, TIAN Qing, ZHOU Ying* 020306

·Materials & Devices & Processes·

- Quality Evaluation for Electronic Components Based on Process Control and Parameter Distribution Capability
..... *LI Jiantao, SUN Ming, ZHANG Haiming, NING Yongcheng, JIANG Chengzhi* 020401
- Optimum Design of Multi-Field Limiting Ring Termination Structure
..... *ZHUO Ningze, LAI Hsinchang, YU Shiheng* 020402

·Packaging Frontiers Report·

- Designing and Fabricating Epoxy Packaging Materials to Integrate High Insulation and Heat Resistance Performances
..... *ZHANG Song, DU Bin* 020601

ISSN 1681-1070

CN32-1709/TN

万方数据

发行范围：国内外公开发行

定 价：25.00 元